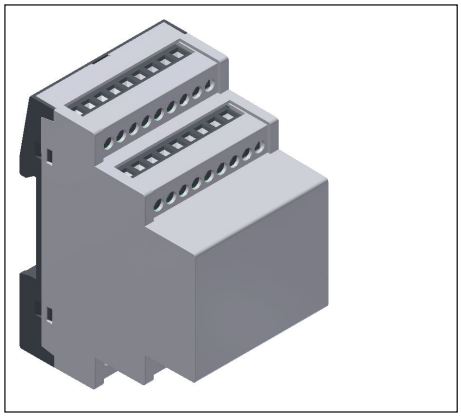
Boîtiers isolants KU 4584

selon DIN 43 880 pour tableaux de distribution profondeur utile 55 mm



Vos avantages

- Modulaire et flexible
- En maximum d'espace
- Connectique variable
- Adaptation personnalisée aux souhaits du client

Propriétés

- Largeur 52,5 mm
- Profondeur assignée 53 mm pour cote de profondeur max. 55 mm selon DIN 43880
- Exécutions possibles:
  - sans bornes
  - avec bornes à circuits imprimés
  - avec bornes à vis enfichables
  - avec bornes à ressorts enfichables
  - avec combinaisons de différents types de bornes
- Peuvent recevoir jusqu'à 2 circuits imprimés avec bornes et platine supplémentaire pour affichage ou organes de commande sur la face avant; en option peuvent recevoir jusqu'à 6 circuits imprimés avec bornes
- Sur demande, ouvertures pour bornes de raccordement et organes de commande KNX et RJ45
- Option plaque de fond avec cloisons latérales pour monter les modules de circuits imprimés

Caractéristiques techniques

Références de commande:	UL	
sans bornes:	0066459	
bornes à circuits imprimés:	0066460	
bornes à vis enfichables:	0066461	
bornes à ressorts enfichables:	0066674	
Dimensions extérieures:	52,5 x 90 x 60	
Matériau des boîtiers:		
capot:	PC-GF, PC (UL) gris clair RAL 7035	
plaque de fond:	PC-GF, PC (UL) noir d'ébène RAL 9005	

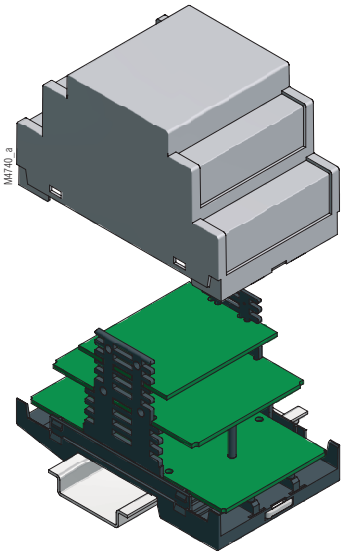
Résistance à la température		PC (UL)
selon UL 746 B:		115 °C
selon Vicat ISO 306	méth. B:	146 °C
selon EN 75-2	(1,8 MPa):	123 °C
	(0,45 MPa):	142 °C

Puissance dissipée max.:	6 W pour boîtier individuel en climat normal 23/50-1	ISO 554
Résistance thermique spécifique:	R_{th} = 10 K / W	
Comportement à la combustion selon UL 94:	tous les matériaux de boîtier V-0	
Nombre de bornes:	36, moins sur demand	
Fixation des boîtiers:	par encliquetage sur rail	EN 60 715
Tenue aux lignes de fuite PC:	CTI 175 ≙ matériau isolant III a	IEC 60 112
Degré de protection:	face supérieure IP 40 plaque de fond IP 30 (ouvertures pour raccordement IP 20)	IEC 60 529
Zone d'inscription:	50 x 41,5 mm	
Platine de C.I.:	voir découpes	
Supports des platines, horizontal:	fixation sur la plaque de fond par vis et / ou au-dessus des cloisons latérales	
Supports des platines, vertical:	par nervures dans le capot	

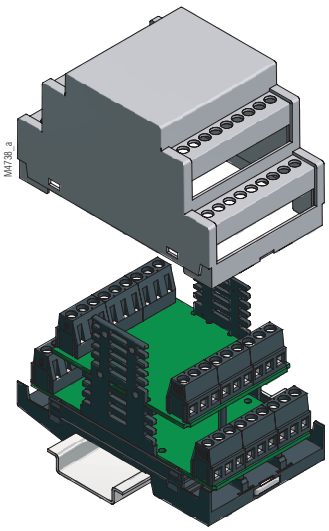
D'autres informations sur notice G02 "Présentation du terminal"

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l'édition en cours. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.

Schémas éclaté

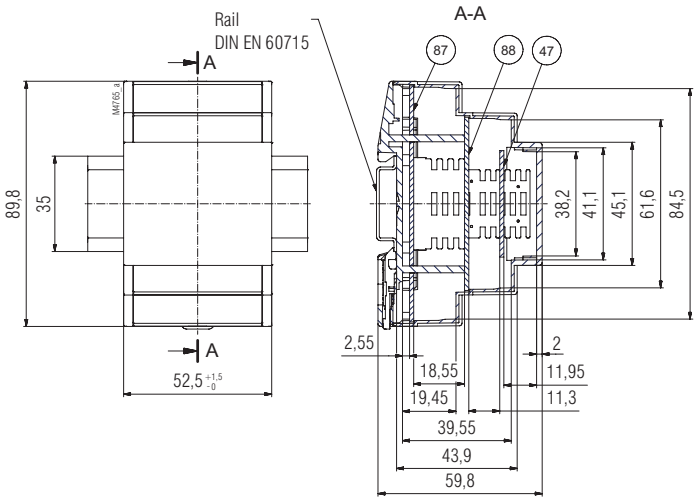


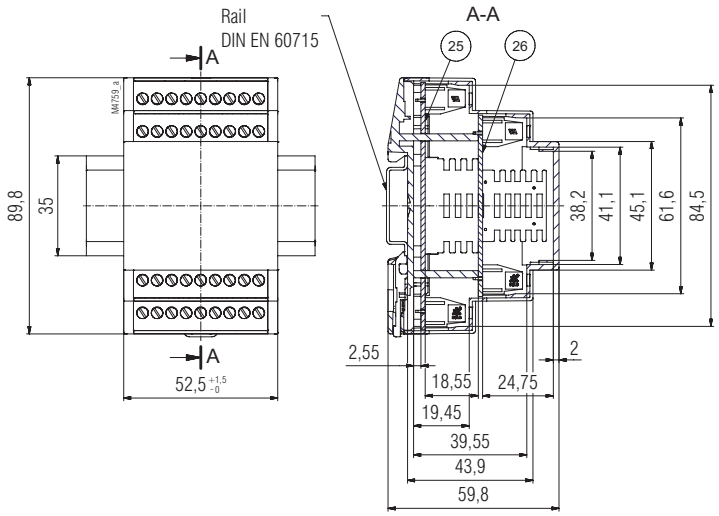
sans bornes



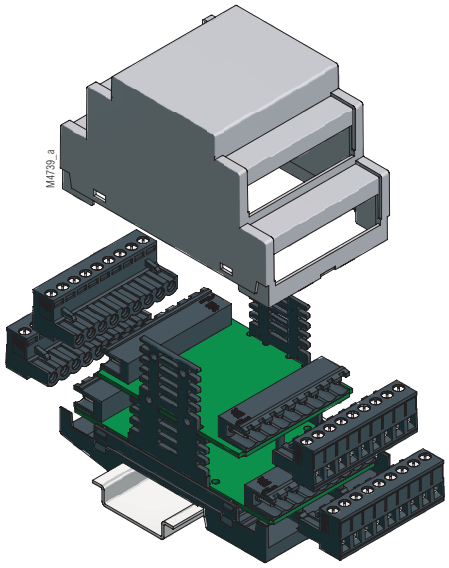
Bornes à circuits imprimés

Dimensions

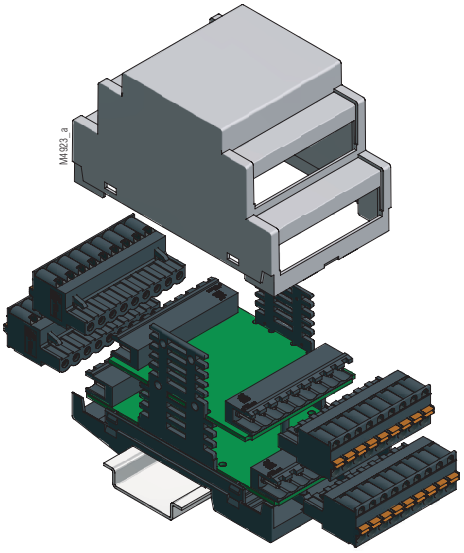




Schémas éclaté

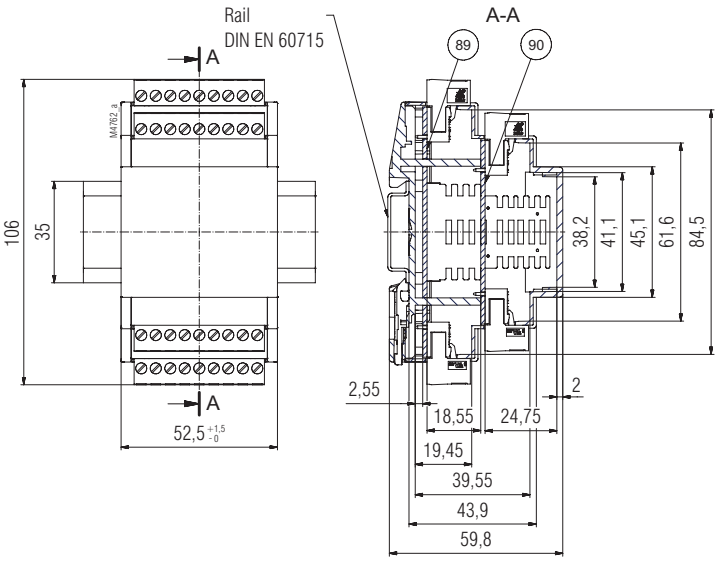


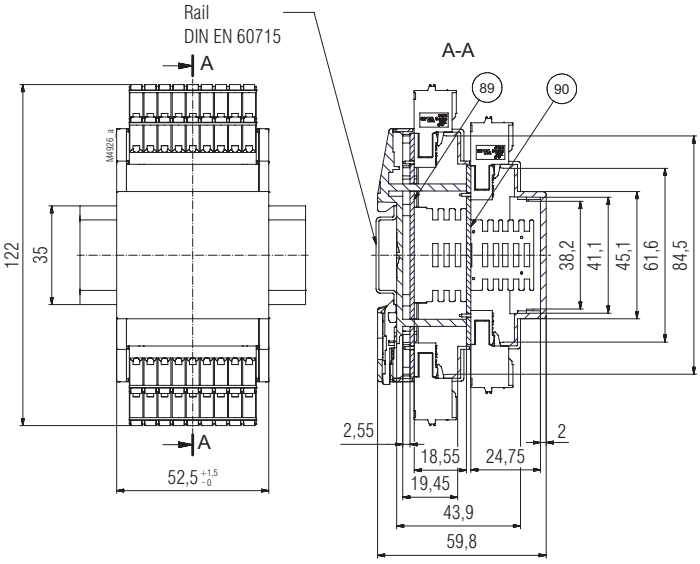
Bornes à vis enfichables



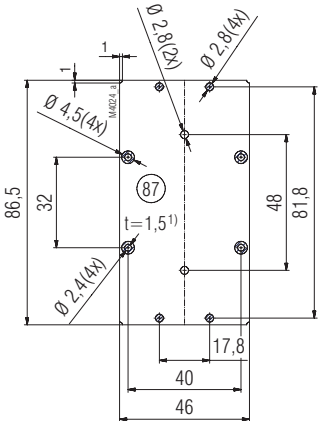
Bornes ressorts enfichables

Dimensions

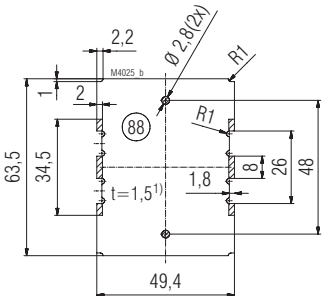




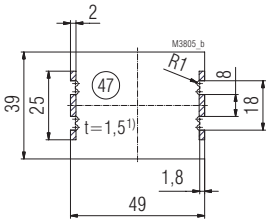
Découpes des cartes de C.I.



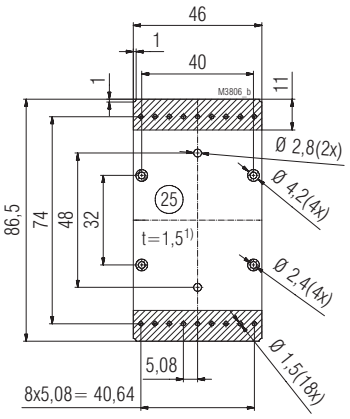
Cartes de C.I. en position C.I. fond
pour boitiers fermés ou fraisés



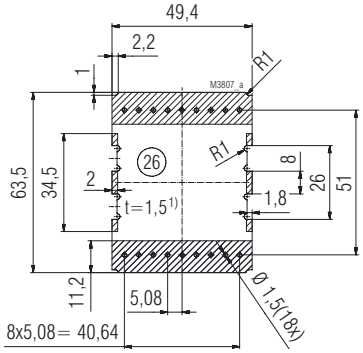
Cartes de C.I. en position C.I. centre
pour boitiers fermés ou fraisés



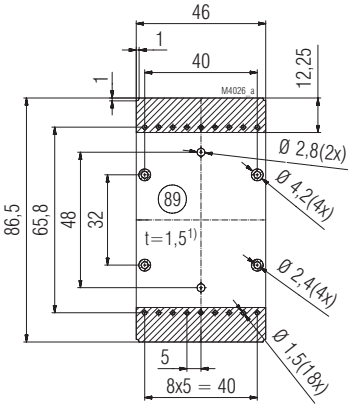
Cartes de C.I. en position C.I. devant
pour boitiers fermés ou fraisés



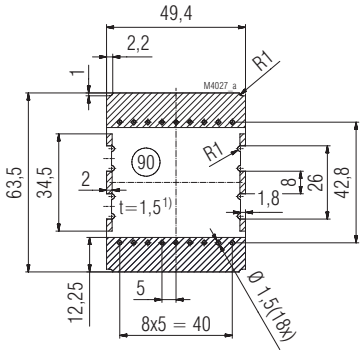
Cartes de C.I. en position C.I. font
pour bornes à circuits imprimés 2 x 9 pôles



Cartes de C.I. en position C.I. centre
pour bornes à circuits imprimés 2 x 9 pôles



Cartes de C.I. en position C.I. fond
pour bornes enfichables 2 x 9 pôles



Cartes de C.I. en position C.I. centre
pour bornes enfichables 2 x 9 pôles

Surface interdite

1) Tolérance selon DIN EN 60 249-2-4, Tolérance générale: PERFAG 2 E
trous ø 2,4 si nécéssaire. pour visser sur la plaque inférieure avec un vis cylindrique de ISO 1207 M2x4